

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 6 月 9 日 (09.06.2005)

PCT

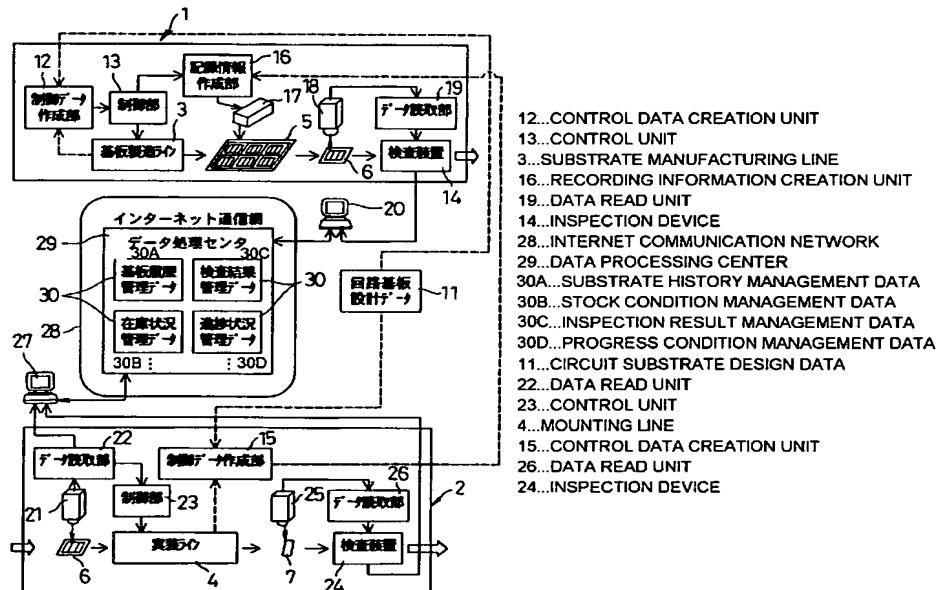
(10) 国際公開番号
WO 2005/052705 A1

- (51) 国際特許分類: G05B 19/418 (72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/017467 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 小林徳實
(22) 国際出願日: 2004 年 11 月 25 日 (25.11.2004) (KOBAYASHI, Tokumi).
(25) 国際出願の言語: 日本語 (74) 代理人: 石原勝 (ISHIHARA, Masaru); 〒5300047 大
(26) 国際公開の言語: 日本語 阪府大阪市北区西天満 3 丁目 1 番 6 号辰野西天満ビ
(30) 優先権データ: ル 5 階 Osaka (JP).
特願 2003-398401 (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
2003 年 11 月 28 日 (28.11.2003) JP 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電 器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUS-
TRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大 字門真 1 0 0 6 番地 Osaka (JP).
VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[続葉有]

(54) Title: CIRCUIT SUBSTRATE MANUFACTURING METHOD AND SYSTEM, SUBSTRATE USED FOR THE SAME, AND CIRCUIT SUBSTRATE USING THE SAME

(54) 発明の名称: 回路基板の生産方法とシステム、並びにそれに用いる基板及びそれをを用いた回路基板



(57) Abstract: There is provided a circuit substrate manufacturing method for manufacturing a circuit substrate in two steps: the first step for manufacturing a substrate at a substrate manufacturer (1) and the second step for mounting electronic parts on the substrate for manufacturing a circuit substrate at a mounting manufacturer (2). At one or more division stages, the substrate board (5) is divided via substrate sheets (6) to substrate pieces (7). By using the substrate board (5), identification information consisting of information associated with the entire substrate board and information indicating relative relationship by divisions at each division stage is recorded on

[続葉有]



(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 国際調査報告書

respective information recording units (8, 9, 10) arranged to correspond to the substrates before and after the division at each division stage before the substrates are delivered from the substrate manufacturer (1) to the mounting manufacturer (2). By referencing the identification information, it is possible to easily trace the history, i.e., trace a manufacturing progress of the circuit substrate divided and a manufacturing history when a defect is caused while increasing the productivity of the circuit substrate by using the multi-piece substrate.

(57) 要約: 基板メーカー(1)で生産した基板を後続する実装メーカー(2)に流通させ、実装メーカー(2)にて電子部品を実装して回路基板を生産する回路基板の生産方法であって、1又は複数の分割段階でそれぞれ基板シート(6)を介して基板ピース(7)に分割される基板ボード(5)を用い、かつ各分割段階の分割前と分割後の各基板にそれぞれ対応させて設けてなる各情報記録部(8、9、10)に、基板全体に係る情報と各分割段階での分割による相対関係を示す情報とからなる識別情報を記録して基板メーカー(1)から実装メーカー(2)に基板を流通させ、識別情報を参照することでその履歴を追跡できるようにしたことにより、多数個取り基板を用いて回路基板の生産能率を高めながら分割された回路基板の生産進捗状況の追跡や欠陥発生時の生産履歴の追跡を容易に行うことができる。